



TIF®030AB-05S 是一种高导热液态间隙填充材料，具有双组份及不同温度固化时间特点。其柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，能提高发热电子组件的效率和使用寿命。以液态方式，提供各种厚度，取代一般导热垫片的模切厚度，且不同于一般硅胶片，此系列产品固化后是干燥可触摸的，故可被更广泛应用。

特性

- 》良好的热传导率：**3.0 W/mK**
- 》双组份材料，易于储存
- 》优异的高低温机械性能及化学稳定性
- 》适用于低压力环境
- 》可依温度调整固化时间
- 》可用自动化设备调整厚度

应用

- 》计算机硬件
- 》通信设备
- 》汽车用电子设备
- 》导热减震设备
- 》散热片及半导体

TIF® 030AB-05S 系列特性表

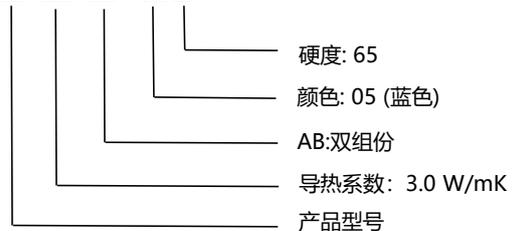
未固化材料特性		
性质	典型值	测试方法
A组份颜色	白色	目视
B组份颜色	蓝色	目视
A组份粘度 (mPa·s)	900,000	GB/T 10247
B组份粘度 (mPa·s)	1,500,000	GB/T 10247
挤出量 (g/min)	25	兆科测试 (50 cc针筒/管口直径 1.5 mm/90 psi)
密度 (g/cc)	3.1	ASTM D297
最小界面厚度 (mm)	0.2	兆科测试
热阻抗 @10psi (°C·in ² /W)	0.75	ASTM D5470
热阻抗 @50psi (°C·in ² /W)	0.45	ASTM D5470
混合比例	1:1	-
保质期	12 个月	-
固化条件		
操作时间 25°C	30 分钟	兆科测试
固化时间 25°C	16 小时	兆科测试
固化时间 70°C	60 分钟	兆科测试
固化后材料性能		
颜色	蓝色	目视
硬度 (Shore OO)	65	ASTM D2240
建议工作温度 (°C)	-45 ~ 200	兆科测试
击穿电压 (V/mm)	≥5500	ASTM D149
阻燃等级	V-0	UL 94
导热系数 (W/mK)	3.0	ASTM D5470

产品规格

50 cc/支, 48 支/箱 或 400 cc/支, 9 支/箱, 或在注射器用于自动化应用定制包装。如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

产品型号说明:

TIF 030 AB - 05 S



全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com
 www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。

